

第32回 ファインテックジャパン

展示会
のご案内

会期 2022年12月7日(水)～9日(金)
10:00～18:00(最終日は17:00まで)

会場 幕張メッセ

小間番号:36-29(5ホール)

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

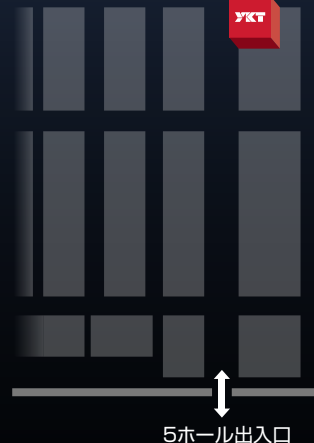
この度、YKTブースでは当社ブランドの高精度フリップチップボンダーと

OGP/QVI社のマルチセンサ三次元測定機を展示・実演いたします。

FPDはもとより、半導体・電子デバイス等、様々な接合用途に対しての

最適解を、豊富なソリューション事例をもとに提案いたします。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。



フリップチップボンダー FC100M

高剛性高精度ボンディングヘッド上下にセラミックヒーターを
採用することで実装精度 $\pm 1\mu\text{m}$ を実現。

試作から量産までマルチに対応する高精度フリップチップボンダー

電子デバイス用途から車載用部品にいたるまで幅広いアプリケーションへのフリップ
接合に適応しています。独自アルゴリズムの採用による高精度実装と、高荷重から
低荷重まで安定した推力により、多様な実装プロファイルに対応します。



マルチセンサ三次元測定機 SmartScope® ZIP 250E

検査現場の“最適解”となるマルチセンサ測定機

カメラ、接触式プローブ、レーザセンサを1台の測定機に集約。
様々な箇所を段取り替えのない安定した測定と測定時間の短縮が可能です。

